



# No residue™ flux IF 2005

INTERFLUX®  
ELECTRONICS N.V.



Datos Técnicos IF 2005

Ver: 1, 20-nov-06  
última versión en [www.interflux.com](http://www.interflux.com)

Page 1

## Flux No limpieza, libre de halógenos , No residue™

### Description:

Interflux® IF 2005M es un flux de No- limpieza con bajo nivel de residuo, diseñado para evaporarse completamente durante el proceso de soldadura. Esto quiere decir que es el flux de No-Limpieza más apropiado para placas de alta tecnología.

Sin resina para crear un residuo pegajoso, no queda nada después de pasar por la ola de estaño para poder llevar a cabo test de pins o prevenir contactos eléctricos. Este flux libre de hálidos cumple con todos los requerimientos de Bellcore e IPC y está listado en QPL(conforme a MIL-F-14256F). Está formulado para proveer la mejor combinación de soldabilidad, facilidad de proceso y confianza. Gran soldabilidad en HAL, NiAu y OSP PCB' s !

IF2005M dispone también de una excelente soldabilidad en aleaciones libres de plomo. Es resistente a elevadas temperaturas de precalentamiento, y a largas exposiciones de contacto con el estaño así como altas temperaturas del mismo.

Interflux® IF 2005M está diseñado para trabajar correctamente con todos los fluxadores de espumación,

así como ser compatible con todos los sistemas de spray y fluxadores de olas. Tienen una mayor durabilidad en la cuba de flux de los sistemas de espumación que los fluxes sintéticos, además de hacerle el más efectivo en coste de los fluxes de No limpieza.



### Otra información:

<i>Seguridad</i>	2
<i>Resultados de Test</i>	2
<i>Envasado</i>	3

### Ventajas clave:

- QPL listada
- Libre de Halógenos
- Para sin plomo
- Tecnología No residue™

## Propiedades físicas

Apariencia	Claro, incoloro
Porcentaje no volátiles	1,8%
Densidad a 20°C	0,808 g/ml
Contenido Agua	3-4%
Número ácido	14 – 16 mg KOH/g
Punto Flash T.O.C	15°C (59°F)



## Seguridad

Interflux® IF 2005  
Flux de No Residuo es  
un material inflamable  
debidamente etiqueta-  
do.

Evite exponerlo a  
Fuentes de calor, chis-  
pas o llamas.

Existen hojas de segu-  
ridad e higiene a su  
disposición.

## Test results

conform EN 61190-1-2(2002) and IPC J-STD-004A/J-STD-005

Property	Result	Method
<b>Chemical</b>		
qualitative copper mirror	<b>pass</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
qualitative halide		
silver chromate (Cl, Br)	<b>pass</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
spot test (F)	<b>pass</b>	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35.1
<b>Environmental</b>		
SIR test	<b>pass</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3



## Envasado

Interflux® IF 2005 esta disponible en envases de: 10, 25 y 200 litros

Interflux® IF 2005 tiene una vida mínima de 24 meses cuando se mantiene en su envase original debidamente cerrado y sellado

D i s c l i m e r

Because we cannot anticipate or control the many different conditions under which this information and our products may be used, we do not guarantee the applicability or the accuracy of this information or the suitability of our products in any given situation. Users of our products should make their own test to determine the suitability of each such product for their particular purposes. The product discussed is sold without such warranty, either express or implied.

Product information in other European languages can be obtained at Interflux® Electronics NV, 9042 Gent. Because we cannot anticipate or control the many different conditions under which this information and our products may be used, we do not guarantee the applicability or the accuracy of this information or the suitability of our products in any given situation. Users of our products should make their own tests to determine the suitability of each such product for their particular purposes. The products discussed are sold without such warranty, either expressed or implied.

Copyright:

**INTERFLUX®** ELECTRONICS

For the latest version of this document please consult:

[www.interflux.com](http://www.interflux.com)